

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2024 年 2 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年通过切实地履行《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，以及制定能进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下：

一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力

过去一年中，公司始终坚持“技术差异化、产品平台化、客户全球化”战略。公司利用技术差异化优势，提升产品的市场竞争力，成功把握市场机遇；凭借深入推进产品平台化，日益完善自身产品矩阵，满足了客户的多样化需求，市场认可度不断提高；通过稳步推进客户全球化，持续加大市场开拓力度，成功扩大客户群体。得益于对既定战略的坚持以及全体员工的共同努力，公司经营业绩在 2024 年继续保持增长，全年共实现营业收入 561,774.04 万元，同比增长 44.48%，实现归属于上市公司股东净利润 115,318.81 万元，同比增长 26.65%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,108,846,723.27 万元，同比增长 27.79%。

1、把握市场机遇，加强新客户拓展与深化老客户合作并举

根据SEMI数据，全球半导体设备市场规模预计在2024年将达到1,090亿美元，2025年的销售额预计将创下1,280亿美元的新高。

2016-2025E 全球半导体设备市场规模



数据来源：SEMI

近年来，全球半导体产业产能扩张仍在继续，对半导体设备的需求稳定增长。公司顺应此趋势积极拓展新客户和开发新市场，成功打开新市场并开发了多个付款履约较好的新客户，在提升了整体营业收入的同时，亦缓解了公司回笼资金的压力，使得公司资金利用效率和现金流情况得到改善。此外，公司在现有的技术储备的基础上，不断对工艺、技术进行迭代、改进，并积极提高员工服务水平，通过提供更为优质的产品和服务，巩固、深化与老客户的关系。2025年，公司将继续把握半导体行业发展机遇，紧紧围绕下游客户需求，采用加强新客户拓展与深化老客户合作并举的方式，在加快新客户拓展以及新产品验证进程的同时，亦努力提高现有产品的市场占有率，推动公司进一步发展壮大。

2、坚持差异化创新，加强研发投入与成果转化

半导体专用设备企业的研发能力是其核心竞争力的关键。随着半导体技术的快速发展，半导体工艺制程不断缩小，半导体芯片结构越来越复杂，制造工艺的难度也不断增加，对半导体设备的功能和性能要求不断提高。公司对技术研发高

度重视，并持续保持高强度的研发投入，以实现半导体设备的持续迭代研发，适应新的市场需求。公司 2024 年度研发投入为 83,847.50 万元，同比增加 27.36%，占公司 2024 年度营业收入的比例为 14.93%。此外，公司同样重视技术成果转化，2024 年公司及控股子公司共申请专利 311 项，比上年增长了 89.63%，截至 2024 年末累计申请专利 1,526 项，比上年末增长了 37.11%。2024 年，公司及子公司共获得专利权 38 项，截至 2024 年末公司及子公司拥有已获授予专利权 470 项（其中发明专利共计 468 项），比上年末增长了 8.05%，其中境内授权专利 176 项，境外授权专利 294 项。

除将技术成果转化为专利外，公司更加重视让自身的技术成果“落地”，形成新工艺、新技术乃至新设备，从而为客户提供更优质、更领先的半导体专用设备及工艺解决方案。2024 年期间，公司顺利交付了湿法设备 4,000 腔，推出了用于先进封装的带框晶圆清洗设备、适用于扇出型面板级封装应用的 Ultra C vac-p 负压清洗设备、用于扇出型面板级封装（FOPLP）应用的新型 Ultra C bev-p 面板边缘刻蚀设备等。公司清洗设备产品 Ultra C Tahoe 亦取得重要性能突破，使得在中低温硫酸（SPM）清洗工艺中，该设备可以达到独立单片晶圆清洗设备的效果，并可减少高达 75%的化学品消耗。此外，公司推出的等离子体增强原子层沉积炉管已进入中国 2 家集成电路晶圆制造厂，正在做更新优化和为量产准备。

未来公司将一如既往地坚持差异化创新，重视研发投入与成果转化，进一步强化基础研发能力建设，结合市场需求开展对新工艺、新技术的前瞻性布局，依托公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的募投项目“高端半导体设备迭代研发项目”、“研发和工艺测试平台建设项目”，更高效地研发制程节点更领先、覆盖工艺环节更丰富、性能指标更领先的新设备，从而推动产品技术高效升级，实现研发及产业化的良性循环。2025 年公司将保持研发投入占营业收入的比例在 15%左右。

3、稳妥推进再融资事项及其募投项目的实施

公司于 2024 年 11 月 11 日收到上海证券交易所出具的《关于受理盛美半导体设备（上海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，目前公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项正接受交易所的审核中。公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的募投项目“高端半导体设备迭代研发项目”、“研发和工艺测试平台建设项目”以及补充流动资金，与公司主营业务紧密相连，系公司未来发展的重要基石之一，亦是公司未来发展战略的重要方向。2025 年，公司将结合市场情况稳妥推进再融资事项，同时以自有资金先行投入上述募投项目，保障项目的顺利开展。

4、积极投资行业内优质企业

2024 年期间公司对海普瑞（常州）洁净系统科技有限公司、安徽晶纭先进材料有限责任公司、苏州芯仪半导体科技有限公司、常熟市兆恒众力精密机械有限公司等半导体产业链上下游企业进行了股权投资。此举措提升了公司在产业链上的协同性，亦在一定程度上维护了公司自身供应链的稳定和安全，为公司的长期可持续成长奠定基础。

二、进一步加快、加强对募投项目的推进、管理，巩固提升科技创新成果

2021 年 11 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 368,523.90 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入金额	投入进度
1	盛美半导体设备研发与制造中心	120,000.00	121,753.39	101.46%
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,458.74	101.02%
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	100.00%
4	高端半导体设备拓展研发项目	73,087.15	74,434.75	101.84%
5	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	24,500.00	-	0.00%
合计		327,587.15	306,646.87	93.61%

注：上述募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金整体投入进度已经达到 93.61%。

公司 IPO 募投项目除“盛美半导体设备研发与制造中心”项目以及“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目外，其余 IPO 募投项目均已完成投入。

公司为了更好地维护自身及股东的利益，规避因全球营商环境变化带来的风险；同时，为加快“盛美半导体设备研发与制造中心”项目的整体投产进度，进一步提高募集资金的使用效率，保障该项目可按期完工；公司经过审慎考虑后分别于 2025 年 1 月、2 月召开董事会以及股东大会，决议对“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目进行终止并将拟投入的募集资金 24,500.00 万元变更投入至“盛美半导体设备研发与制造中心”项目。

2021 年 11 月上市以来，公司 IPO 募投项目均取得了较好的成果。在 IPO 募投研发项目方面，公司对 Tahoe 单片槽式组合清洗设备、背面清洗设备、前道刷洗设备、前道铜互连电镀设备、立式炉管设备等进行了改进和产业化，并掌握了一系列新技术；对 PECVD 设备等进行了研发，完成了基础型设备的设计制造和功能性验证，扩展了公司的产品线，目前 IPO 募投研发项目已经基本达到了既定的研发目标；得益于上述募投研发项目取得的良好效果，公司对多种清洗设备、电镀设备、炉管设备进行了技术升级，成功推出了多款具有自主知识产权的新设备，标志着公司在半导体设备领域的平台化战略已初步实现。在项目建设方面，截至 2024 年 12 月 31 日，“盛美半导体设备研发与制造中心”项目建筑主体基本完工，剩余部分建筑的内部装修、部分设备的采购和调试安装、建筑顶部和周围的绿化工程尚待完成。

在上述成果的基础上，公司营业收入由 2021 年的 162,086.91 万元提升至 2024 年的 561,774.04 万元，年均复合增长率达 51.33%，净利润由 2021 年的 26,624.82 万元增长至 2024 年的 115,318.81 万元，年均复合增长率达 63.01%。公司 IPO 募投项目对提升公司技术水平、经济效益，丰富产品类型，增强综合竞争力发挥了重要作用。

2025 年，公司为进一步巩固、提升 IPO 募投项目的研发成果，将“高端半导体设备迭代研发项目”作为 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的募投项目之一，对公司产品的进行迭代升级和研发，研发制程节点更领先、覆盖工艺环节更丰富、性能指标更领先的新设备；在项目建设方面，公司持续关注“盛美半导体设备研

发与制造中心”项目的执行进度。为进一步提高募集资金的使用效率，以及保障“盛美半导体设备研发与制造中心”项目顺利推进，公司于2025年初分别召开董事会与股东大会，决议终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入的超募资金24,500.00万元变更投入至“盛美半导体设备研发与制造中心项目”。除此之外，2025年公司将会一如既往地加强对募投项目的管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

三、优化运营管理，提高经营质量与效率

2024年，通过优化协同合作的内部管理制度（如每天更新销售订单回款情况、每季度汇总并讨论每台设备收款情况等）推进应收账款回款速度；对于长账龄应收账款，通过设立售后现场经理制度，及时将设备运行情况反馈给销售部门，销售部及时通过向客户电话或当面沟通协调等方式催款，公司加强了应收账款跟踪与监控，同时公司积极开拓市场，新增了付款履约较好的新客户，使得公司现金流状况得到显著改善，公司2024年度经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到121,614.30万元。此外，公司对存货管理系统进行进一步的完善优化，健全库存管控体系，优化库存、设置更合理的库存警戒、加快新产品在客户端的验收、做好订单回款收款管理工作、落实相关人员对物料的购买和消耗的全过程责任、优化考核要求等举措，完成系统追踪的闭环管理，控制公司库存量、提升生产效率和原材料采购效率，并最终提高公司经营质量与效率。2024年公司在提升公司经营质量与效率的基础上，始终以产品质量、技术水平以及客户服务为落脚点，坚持“技术差异化”“产品平台化”“客户全球化”战略，持续改善现有设备内容，深化现有产品线的拓展研发工作，凭借长期研发积累形成的技术优势，以及较高的研发投入，将公司2024年全年平均毛利率稳定在40%-50%之间。

2025年公司将在以下方面持续发力，继续保持经营质量和效率的稳步提升：

1、提高资金使用效率

2024 年公司业务规模增长较快，2024 年 12 月 31 日，公司应收账款金额为 213,227.46 万元，相较于期初增长较大，对公司经营资金形成一定的占用。公司将通过优化库存、加快新产品在客户端的验收、加快回款等举措，提高资金使用效率。

2、夯实供应链稳定安全

公司将持续完善供应链管理体系，通过建立完善的供应链管理制度体系和管理架构，推动供应链的高效、规范管理。公司将科学管理供应厂商，对关键零部件供应商采取多厂商策略，以保障零部件及时供应。另一方面，公司加强与关键零部件本土供应商在技术验证及业务等方面的合作，支持零部件供应商提升其技术水平，以满足公司零部件采购和设备生产的需求。公司将通过以上措施并举，在当前复杂多变的全球营商环境中，夯实自身供应链的稳定安全。

3、保持盈利质量，维持收入增长

未来，公司将始终坚持差异化，持续改善现有设备内容，深化现有产品线的拓展研发工作，加大研发投入，进一步在清洗设备、电镀设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备、涂胶显影 Track 设备、PECVD 设备六大系列产品上进行新产品研发及迭代研发，加快研发成果的产业化，以期在新客户拓展、新市场开发等方面取得进一步的成效，提高公司半导体设备市场占有率，维护公司市场地位，提高公司盈利质量水平，使公司营业收入增长具有持续性，以及将公司 2025 年全年平均毛利率继续维持在 42%-48%之间。

4、完善人才激励措施

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以授予价格 49.78 元/股向符合授予条件的 193 名激励对象授予 139.10 万股限制性股票。后续公司将继续为建立健全长效激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，充分调动员工的积极性和创造性，以进一步吸引和留住优秀人才。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

近几年随着公司快速发展、规模不断扩张，客观环境对公司内控建设和治理水平提出了更高的要求。2024 年公司结合实际经营情况与相关法律法规，全面梳理原有管理制度，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》等 18 项治理制度进行了修订及制定。此外，2024 年公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。董监高积极参与了“ESG 专项培训”“独立董事制度改革专题培训”等上交所等监管机构举办的培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司力求在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，建立适合公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，加强公司员工自律合规意识，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2025 年公司将根据新《公司法》等相关法律、法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改、完善，包括如下措施：

1、依据相关法规，调整公司内部监督机构

公司将在 2025 年内按照新《公司法》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事（在公司完成前述内部监督机构设置前，公司监事会或者监事将继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定）。

2、继续完善公司相关内控制度，积极响应人员培训工作

公司将继续根据实际经营情况，以及相关法律法规变动，持续完善内控制度的建立健全工作，保障公司内部控制制度及时地推陈出新，从而形成更符合监管机构要求以及公司实际经营情况的内控体系。同时，公司及其董监高将积极参加交易所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

3、为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制

公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立

董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用。

4、夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视 ESG 管理体系的建设工作，建立了自上而下的 ESG 管理架构，通过构建董事会监督、经营管理层下 ESG 领导小组管理、ESG 工作小组执行的 ESG 治理机制，推动落实公司在环境保护、员工权益、公司治理等方面的 ESG 工作。本年度，公司在绿色制造、资源循环利用、供应链管理、碳排放管理等方面均取得新突破。同时，公司在国际及国内主流 ESG 评级体系中的表现进一步得到认可，并获得相关评级机构的最新评估结果，反映了公司在环境、社会及公司治理方面的持续改进和实践深化。

2025 年公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

五、持续加强投资者沟通交流，提升信息披露透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持“以投资者为中心”的理念，积极主动地与投资者进行沟通交流，及时、准确地传递公司信息，倾听投资者的意见和建议，努力为投资者提供全方位、高质量的服务，为构建稳定、良好的投资者关系奠定坚实基础。公司积极接听投资者专线，通过 IR 邮箱回复投资者问询，并在“上证 E 互动”平台与投资者保持密切互动。定期报告披露之后，公司会在“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办投资者交流会，深入阐述公司的经营业绩，并对定期报告进行详细解读，帮助投资者更好地理解公司的财务状况和业务发展情况。此外，公司还充分利用“盛美上海”公众号平台，以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示，方便投资者快速把握公司的财务动态。公司将持续遵循法律法规，不断优化投资者关系管理体系，提升管理质量，以实现公司价值和股东利益的最大化。

2024 年度，公司在上证路演中心以视频录播和网络互动的方式共召开 4 次

业绩说明会；借助电话会议系统等线上方式，举行投资者调研活动，接待包括卖方证券研究所、证券投资基金公司等机构投资者调研交流 32 次。此外，公司亦在官网设置投资者关系专栏以及“盛美上海”公众号平台，方便投资者及时把握公司的最新信息。2024 年期间公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，信息披露真实、准确、完整和及时，并确保公司信息披露透明度。

2025 年公司将继续完善投资者的管理工作，强化与投资者的互动沟通，拓宽与投资者的交流渠道，依托“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于 8 次投资者线上交流会。在完成临港研发制造中心的整体建设后，公司计划在临港研发制造中心举办投资者座谈会，邀请投资者对临港研发制造中心进行参观，并与投资者面对面交流，对公司业务经营、发展规划以及临港研发制造中心的具体情况介绍。公司将进一步利用公司官网以及“盛美上海”公众号平台，让投资者通过多种渠道，更便捷、及时地获取公司相关信息。

六、持续完善投资者回报机制，提升投资价值

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报。2024 年 1 月 26 日，公司制定并披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，公司将根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司董事长 HUI WANG 所提议的议案：未来 3 年（2024 年至 2026 年）的现金分红，每年保持在当年归属于上市公司股东净利润的 25%-30%之间。同年 6 月公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 7 月 19 日实施权益分派，以每股现金分红 0.62636 元（含税），总计分红 27,318.91 万元（含税），占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 30%，较好的践行了董事长 HUI WANG 的提议、公司分红回报规划以及《公司章程》规定的利润分配原则。

2025 年公司将继续秉持“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动。与此同时，公司亦将继续努力践行《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》以及董事长 HUI WANG 于此前的分红提议，统筹好公司的经营状况、业务发展目标以及股东回报，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让投资者共享公司的发展成果，增强投资者价值获得感。

为切实贯彻股东回报战略，公司基于 2024 年度经营业绩及财务状况，拟实施如下 2024 年度利润分配方案：拟以截至 2024 年 12 月 31 日剔除已回购股份后的总股本 438,740,753 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.57 元（含税），现金红利总额预计为人民币 288,252,674.72 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 25%。该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

七、科学绩效考核，强化利益共享，压实“关键少数”责任

2024 年 1 月 29 日，公司披露《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-010），公司董事、总经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书罗明珠拟自 2024 年 1 月 29 日起 6 个月内增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 900 万元且不超过人民币 1,200 万元。截至 2024 年 4 月 15 日，增持主体累计增持公司股份 138,056 股，增持金额合计为 1,164.94 万元，增持计划已实施完毕。公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以授予价格 49.78 元/股向符合授予条件的 193 名激励对象授予 139.10 万股限制性股票。增持计划、股票激励计划能进一步激发公司管理层等员工的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益、股东利益与公司长远发展有机结合，促进公司经营业绩持续稳步增长。

当下正值公司发展的关键时期，公司将以高质量发展为目标，持续提升公司高管的管理水平和业务能力，优化薪酬激励与约束机制，并进一步研究管理层与股东的利益共担共享机制，依法合规探索长效激励机制，实现利益绑定，强化“关

键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。

八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司严格执行此前制定的行动方案，并取得了一定进展。此后公司将持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，同时坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强与投资者沟通交流，维护公司良好市场形象。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年2月25日